

2026年2月17日



US Conec、白山、SANWA Technologies、超小型フォームファクタ (VSFF) MMC 多心光コネクタおよび TMT フェルールのマルチソース化・共同開発に関する契約を締結

SANWA Technologies, Inc. (Chairman & CEO：石井保雄、以下「SANWA Technologies」)、株式会社白山 (代表取締役社長：米川達也、以下「白山」)、および米国 US Conec Ltd. (President：Joe Graham、以下「US Conec」) は、このたび、超小型フォームファクタ (Very Small Form Factor、以下「VSFF」) である MMC 多心光コネクタ (以下、「MMC 光コネクタ」) および TMT フェルール部品のマルチソース化ならびに開発に関する契約を締結したことを発表いたします。

SANWA Technologies は、これまで展開してきた VSFF MDC デュプレックス (2 心) 光コネクタ・アダプタ (以下、「MDC 光コネクタ」) および MMC 光アダプタに加え、業界で高く評価されている MMC 光コネクタをラインアップに加えることで、VSFF ソリューションをさらに拡充します。また、白山は、低損失 MT フェルール技術における長年にわたる知見を活かし、12 心および 16 心の両バリエーションに対応した TMT フェルールの製造・供給を担います。本協業は、最先端の高密度光接続ソリューションを支える、急速に拡大するサプライチェーン基盤の拡充をさらに後押しするものです。

次世代ハイパースケールデータセンターの光アーキテクチャは、従来の MPO 配線インフラから、より高密度で高機能、スピーディな構築の容易性と優れた性能を備えた MMC 光コネクタプラットフォームへと移行が進んでいます。さらに、CPO (Co-Packaged Optics) や組込み光学技術を採用する新しいネットワークおよびサーバークラスタ技術においても、装置内部および光 I/O 技術の両面で、MMC 光コネクタプラットフォームの高密度性が活用されています。

■SANWA Technologies, Inc. COO & CSO 石川明人からのコメント：

「US Conec との MMC 光コネクタに関するライセンスおよびパートナーシップの拡大を発表できることを、大変喜ばしく思います。当社はこれまでも、MMC および MDC 光コネクタ技術ならびにそのエコシステムへの取り組みを推進してまいりましたが、今後も引き続き、これらを全面的に強化してまいります。さらに今回、低損失多心フェルール製造において高い専門性を有する白山が本パートナーシップに加わることで、3社が連携し、急速に拡大する市場需要に対応する

供給能力を、より迅速に拡充できるものと考えています。当社は、US Conec および白山との本協業に参画できることを、誠に光栄に思います。」

■株式会社白山 マーケティング・事業開発最高責任者 金原竜生からのコメント：

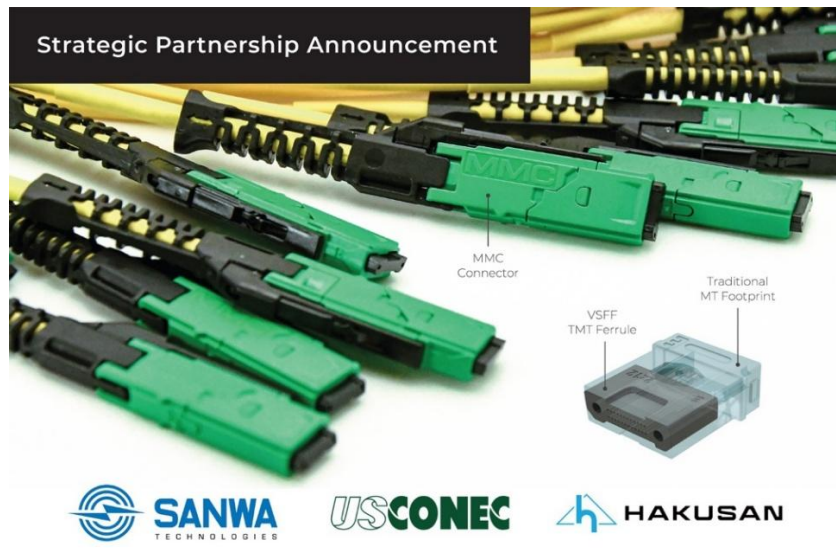
「MMC エコシステムの発展に向け、US Conec および SANWA Technologies と協業できることを大変光栄に思います。当社は、35 年以上にわたり培ってきた高精度 MT フェルルール技術を基盤として、ハイパースケールデータセンターや、プラグブル光トランシーバおよび Co-Packaged Optics を採用する次世代光アーキテクチャに向けて、高性能な TMT フェルルールを提供してまいります。本パートナーシップは、進化し続ける業界の要求に応える高信頼・高密度ソリューションをグローバルなお客様に提供していくという、当社の姿勢を示すものです。」

■US Conec Ltd. Vice President, Product Management Mike Hughes からのコメント：

「信頼性と実績を備えた光接続ソリューションサプライヤーとともに、MMC エコシステムの拡大に取り組めることを、誇りに思います。SANWA Technologies および白山はいずれも、コネクタ部品供給において長年の実績と優れた顧客サポートを有しており、こうした強みを背景に、MMC 光コネクタ市場における安定した供給体制の確立に大きく貢献してくれるものと確信しています。」

US Conec、白山、SANWA Technologies は、2026 年 3 月 17 日～19 日に米国ロサンゼルスで開催される OFC にて、MMC 光コネクタソリューションを展示いたします。

US Conec	ブース 1938 (South Hall)
SANWA Technologies	ブース 1017 (South Hall)
白山	ブース 309 (South Hall)



■本リリースに関する各社お問い合わせ先

US Conec Press Contact:

Ms. Youa Yang-Xiong
Marketing Communications
(828) 624-6417
youaxiong@usconec.com

US Conec Ltd.について

US Conec Ltd は、高密度光インターコネクットの設計および開発のグローバルリーダーです。30年以上の革新的な経験を元に、世界中のデータセンターおよびエンタープライズ構内光配線、公共ネットワーク、オンボード光インターコネクット、産業、軍事市場向けに、業界トップの部品を提供しています。本社は米国ノースカロライナ州ヒッコリーにあり、トップ通信技術企業である Corning Inc.、株式会社フジクラおよび NTT アドバンステクノロジー株式会社が出資しています。詳細は www.usconec.com をご覧ください。

SANWA Technologies Press Contact:

Joseph Kim
Marketing Manager
+1(855)769-8324
joseph.kim@snwtech.com

SANWA Technologies, Inc.について

SANWA Technologies, Inc.は、光通信市場向け機器・部品のリーディングカンパニーである三和テクノロジーズ株式会社の100%子会社です。三和テクノロジーズグループは、75年以上にわたる技術革新の歴史を有し、未来の光ネットワーク技術の発展を支える高品質なコネクティブティソリューションおよび各種コンポーネントの開発、製造を行っています。東京に本社を置き、タイに主要な生産拠点を構えるほか、米国テキサス州およびマサチューセッツ州、ポーランド、台湾にグローバルな販売拠点を展開しています。詳細は www.sanwa-tech.com をご覧ください。

Hakusan Inc. Press Contact:

Ms. Erina Tsubomoto
Lead Marketing
+81-90-3246-9539
p-relations@hakusan-mfg.co.jp

株式会社白山について

株式会社白山は、世界でいち早く MT フェルールの開発に取り組んだ企業の一社として、35年以上にわたり培ってきたエンジニアリングの知見と先進的な製造技術を融合し、データセンターや通信ネットワーク、航空宇宙分野、一般産業用途、さらには次世代光システム向けに、高精度・高密度ソリューションを提供しています。また、白山は Lightera グループの一員として光接続技術におけるイノベーションを加速させる一方で、グローバルに信頼される独立ブランドとしての体制を維持し、事業を展開しています。石川県金沢市に本社を構え、進化を続ける市場において、高い技術力が求められる多心光接続技術に注力しています。詳細は <https://hakusan-mfg.co.jp/> をご覧ください。